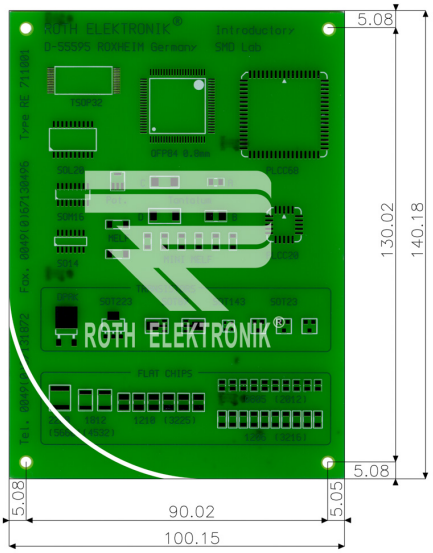

RE711001-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Senza fori
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo), rivestito con maschera di saldatura
- Stampa del componente

- Circuito con 57 esercizi di saldatura per l'introduzione nell'SMD--- | ---PLCC | 20, 68
  QFP | 84 sq.
  TSOP32 | 1 x
  SO14 | 1 x
  SOM16 | 1 x
  SOL20 | 1 x
  SOT23 | 3 x
  SOT143 | 1 x
  SOT89 | 2 x
  SOT233 | 1 x
  DPAK | 1 x
  Poti. | 1 x
  Tantal Chip Kond. A | 1 x
  Tantal Chip Kond. B | 1 x
  Tantal Chip Kond. C | 1 x
  Tantal Chip Kond. D | 1 x
  1206 Chip Kond. | 10 x
  0805 Chip Kond. | 10 x
  1210 Chip Kond. | 6 x
  1812 Chip Kond. | 2 x
  2220 Chip Kond. | 1 x
  2308 Melf | 2 x
  1206 Mini Melf | 6 x

- Adatto anche per l'attrezzatura meccanica (Pick & Place)
- Dimensioni 100 x 140 mm

072025